

特点

- 非绝缘，底板为公共电极
- 国际标准封装：全压接结构，优良的温度特性和功率循环能力
- 低正向压降

典型应用

- 电焊机电源
- 各种DC电源
- 变频器

$I_{F(AV)}$	200A
V_{RRM}	500-2500V
I_{FSM}	$8.0 \text{ A} \times 10^3$
I^2t	$326.4 \text{ } 10^3 \text{ a}^2 \text{ s}$

符号	参数	测试条件	结温 $T_J(^{\circ}\text{C})$	参数值			单位
				最小	典型	最大	
$I_{F(AV)}$	正向平均电流	180° 正弦半波, 50HZ 单面散热, $T_C=100^{\circ}\text{C}$	150			200	A
$I_{T(RMS)}$	方均根电流		150			314	A
V_{RRM}	反向重复峰值电压	$V_{RRM} \text{ tp}=10\text{ms}$ $V_{RSM}=V_{DRM}\&V_{RRM}+200\text{V}$	150	500		2500	V
I_{RRM}	反向重复峰值电流	at V_{DRM} at V_{RRM}	150			20	mA
I_{FSM}	通态不重复浪涌电流	10ms 底宽, 正弦半波 $V_R=0.6V_{RRM}$	150			8.0	KA
I^2t	浪涌电流平方时间积					326.4	$\text{A}^{2\text{S}} \times 10^3$
V_{FO}	门槛电压		150			0.80	V
r_T	斜率电阻					0.96	$\text{m}\Omega$
V_{FM}	正向峰值电压	$I_{TM}=628\text{A}$	25			1.15	V
$R_{th(j-c)}$	热阻抗 (结至壳)	单面散热				0.200	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$
$R_{th(c-h)}$	热阻抗 (壳至散)	单面散热				0.1	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$
F_M	安装扭矩 (M5)					6	N-m
	安装扭矩 (M6)					6	N-m
T_{stq}	储存温度			-40		125	$^{\circ}\text{C}$
W_t	质量						g
Outline	外形						

Peak forward Voltage Vs. Peak forward Current

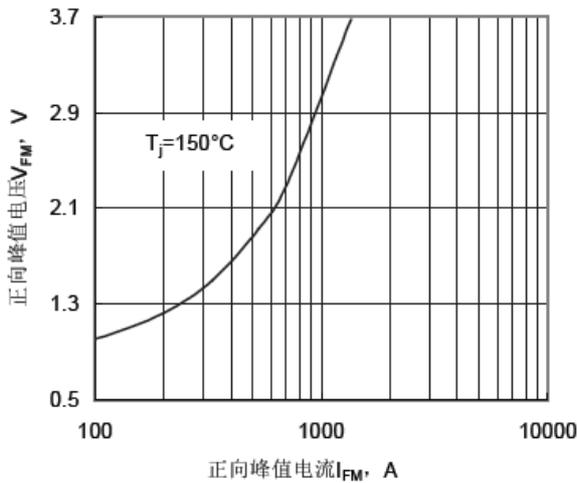


Fig.1 通态伏安特性曲线

Max. junction To case Thermal Impedance Vs. Time

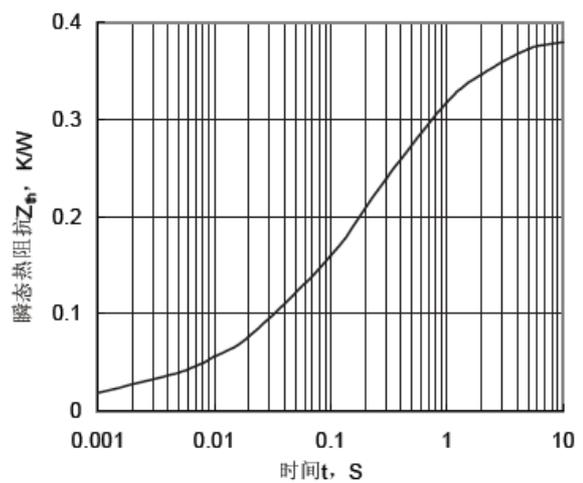


Fig.2 瞬态热阻抗曲线

Max. Power Dissipation Vs. Mean forward Current

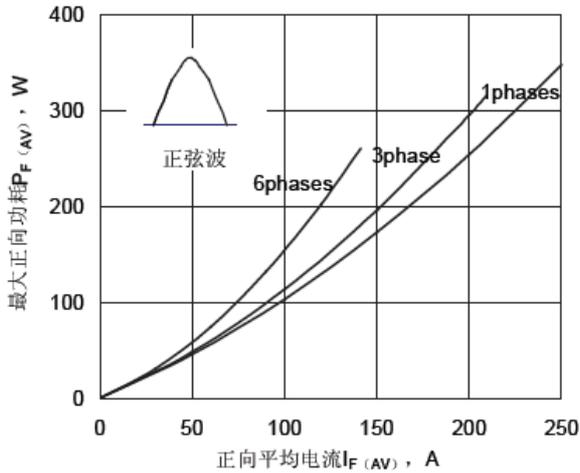


Fig.3 最大功耗与平均电流关系曲线

Max. case Temperature Vs. Mean forward Current

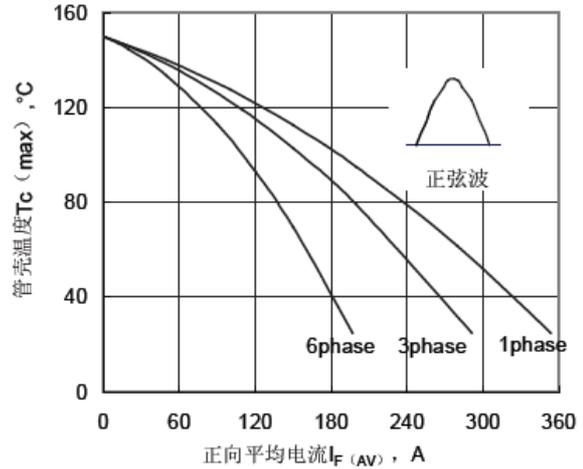


Fig.4 管壳温度与正向平均电流关系曲线

Max. Power Dissipation Vs. Mean forward Current

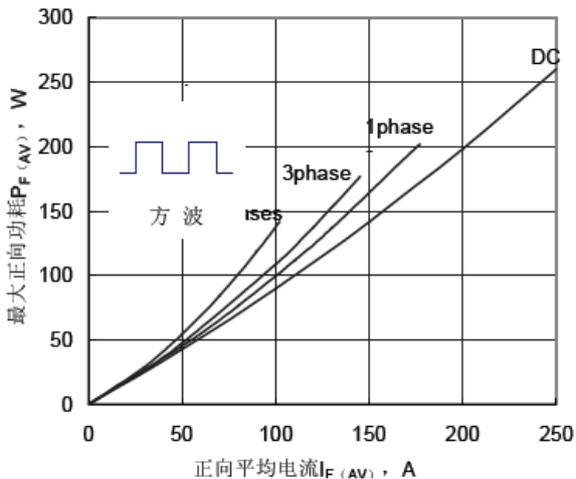


Fig.5 最大功耗与平均电流关系曲线

Max. case Temperature Vs. Mean forward Current

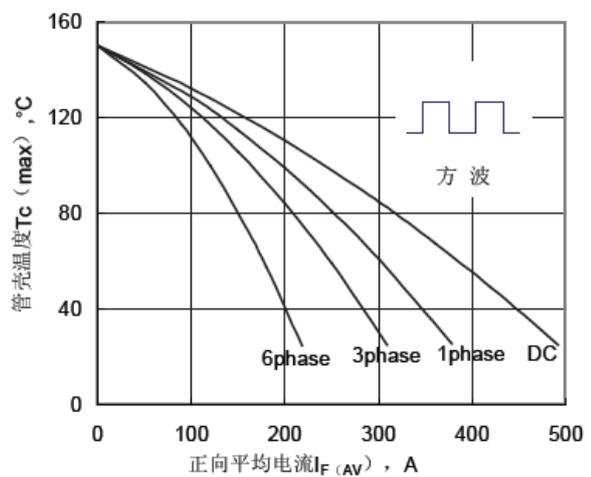


Fig.6 管壳温度与正向平均电流关系曲线

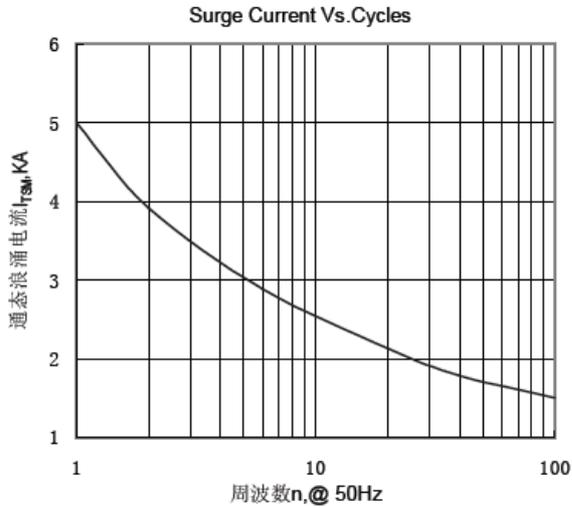


Fig.7 通态浪涌电流与周波数的关系曲线

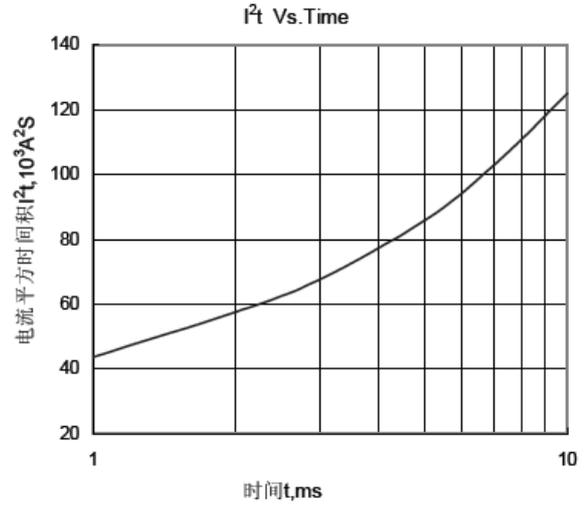


Fig.8 I^2t 特性曲线

外形图:

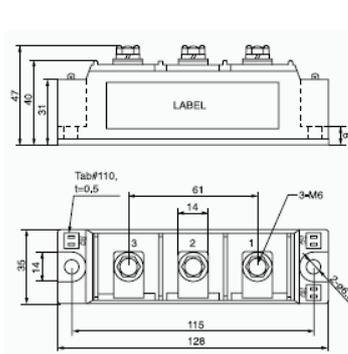


图 1

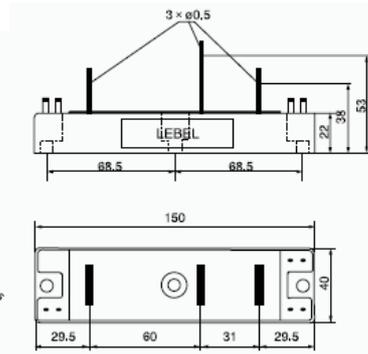


图 2

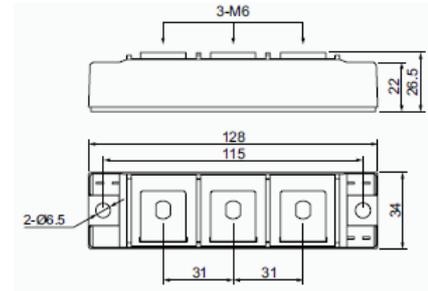


图 3

线路图:

